

<<印制电路板的可制造性设计>>

图书基本信息

书名：<<印制电路板的可制造性设计>>

13位ISBN编号：9787508358239

10位ISBN编号：7508358236

出版时间：2007-9

出版时间：中国电力

作者：姜培安

页数：262

字数：222000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<印制电路板的可制造性设计>>

内容概要

印制电路板（简称印制板）是电子产品的重要基础部件。

由于微电子技术的飞速发展，表面安装技术在电子产品中的应用日益广泛，用于安装表面贴装元器件的印制板结构越来越复杂，安装的要求更加繁多，对于印制板设计需要考虑的因素大量增加，印制板的可制造性已成为广大印制板设计人员十分关注和必须考虑的问题。

本书共分为13章，重点介绍了印制板可制造性的概念，印制板制造与安装可制造性设计的工艺要求和各图形要素的设计。

本文从实际应用出发，对印制板设计过程中印制板的制造、安装和测试等方面的可制造性做了系统的分析和介绍，并根据现行标准和众多设计经验的体会，提供了大量的印制板可制造性数据和图示，力求图文并茂，易于理解。

为使广大读者能更准确地了解印制板的性能和验收要求，书中第十二章对印制板的相关标准还作了详细介绍，便于设计时查找和引用。

本书为印制电路板设计者在考虑可制造性设计或印制板制造和安装的工艺人员对设计文件进行工艺性审查时，提供了方便、实用的工具，也是初学印制板设计的工程设计人员很好的参考资料。

<<印制电路板的可制造性设计>>

书籍目录

第一章 概述 第一节 印制电路板 第二节 印制板组装件 第二章 印制板制造和安装工艺 第一节 印制板的制造工艺 第二节 印制板组装件的制造工艺简介 第三章 印制板设计对基材的选择 第一节 印制板用基材的性能和分类 第二节 常用基材的特性 第三节 基材的选择 第四章 设计可制造性和可测试性的概念 第一节 设计的可制造性概念 第二节 设计的可测试性概念 第三节 印制板组装件的可维修性 第五章 印制板的基本要素设计 第一节 印制板设计的通用要求 第二节 印制板的结构设计 第三节 印制板的外形、尺寸 第四节 印制板的厚度 第五节 坐标网格和参考基准 第六节 导线宽度、长度和间距 第七节 孔与连接盘(埠盘)的形状和尺寸 第八节 接插区和印制插头 第九节 PCB的表面涂(镀)层选择 第十节 电气性能设计 第六章 印制板的电磁兼容设计 第一节 印制板电磁兼容性的重要性 第二节 印制板内引起电磁兼容问题的主要原因 第三节 抑制电磁干扰措施 第七章 PCB的热设计 第一节 热设计的必要性 第二节 热设计的基本要求 第八章 印制板图设计 第一节 印制板图的设计内容 第二节 印制板图的设计程序 第三节 导电图形设计(布局、布线) 第四节 附连板测试图形 第五节 非导电图形设计 第六节 机械加工图 第九章 印制板设计的可制造性检查 第一节 印制板设计的可制造性检查的内容 第二节 印制板可制造性的具体参数 第三节 印制板的可测试性要求和检查 第四节 挠性和刚一挠性印制板设计的特殊要求 第十章 应对绿色环保要求的PCB设计 第一节 概述 第二节 欧洲两项指令和无铅焊接对印制板的要求 第三节 面对绿色法规印制板设计的考虑 第四节 面对绿色法规的PCB制造要求 第十一章 印制板设计的可靠性评价 第一节 产品可靠性的概念 第二节 印制板的可靠性分析 第十二章 PCB设计的相关标准 第一节 PCB标准概况 第二节 国内印制板相关标准 第十三章 印制电路板的发展趋势 附录A 国际和美国印制板主要标准 附录B 缩略词参考文献

<<印制电路板的可制造性设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>